

<<电子整机装配工艺与技能训练>>

图书基本信息

书名：<<电子整机装配工艺与技能训练>>

13位ISBN编号：9787040055993

10位ISBN编号：7040055996

出版时间：1996-5

出版时间：高等教育出版社

作者：陈其纯

页数：130

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子整机装配工艺与技能训练>>

内容概要

《电子整机装配工艺与技能训练》是以国家教委《职业高中（三年制）电子电器专业教学计划》及《电子整机装配工艺教学大纲》为依据，并参照劳动部、电子工业部最新颁布的《电子工业中级工人技术等级标准》编写的。

《电子整机装配工艺与技能训练》内容包括电子整机装配常用元器件、常用工具和常用设备的简介；电子整机装配的准备、焊接、连接、总装、调试、老化、保护以及技术文件和安全文明生产的基础知识和基本内容；电子整机装配工艺技能训练；对于一些新工艺，如表面安装技术、二次焊接工艺和长脚插件一次焊接工艺等也作了简要介绍。

《电子整机装配工艺与技能训练》从中等职业教育的实际出发，突出基础知识，概念清楚、重点明确，语言通俗，具有较强的可读性；同时注重学生基本操作技能的训练与培养，书中安排的装配工艺技能训练简易可行，操作方便；附录中的有关资料及技术文件的格式均为当前整机装配工厂所普遍采用，因此具有较高的实用价值。

《电子整机装配工艺与技能训练》既可作为各类中等职业技术学校电子电器专业整机装配工艺课程的教材，又可作为家用电器及工业电子设备等行业的生产和维修人员的培训及自学用书。

<<电子整机装配工艺与技能训练>>

书籍目录

绪论第一篇 工艺基础知识第一章 电子整机常用元器件、材料和装配工具1.1 常用元器件1.1.1 电阻器1.1.2 电容器1.1.3 电感器1.1.4 半导体分立器件1.1.5 光电耦合器1.1.6 集成电路1.2 常用材料1.2.1 电子产品常用的绝缘材料1.2.2 电线与电缆1.2.3 敷铜板、漆料和有机溶剂1.3 常用装配工具和设备1.3.1 常用手工工具1.3.2 常见的专用设备习题一第二章 整机装配前的准备工艺2.1 元器件的分类和质量检查2.1.1 元器件的分类2.1.2 元器件的质量检查2.2 搪锡技术2.2.1 搪锡前的准备2.2.2 搪锡方法2.2.3 搪锡的质量要求及操作注意事项2.3 元器件引线的成形和屏蔽导线的端头处理2.3.1 元器件引线的成形2.3.2 屏蔽导线的端头处理2.4 线把的扎制2.4.1 线把绑扎的基本常识2.4.2 线绳连续绑扎的要求2.4.3 导线束的防护2.5 电缆的加工2.5.1 棉织线套低频电缆的端头绑扎2.5.2 绝缘同轴射频电缆的加工2.5.3 扁电缆的加工2.6 印制板的加工2.6.1 印制板的优点和分类2.6.2 印制板的制作工艺简介2.6.3 印制板的检验习题二第三章 焊接工艺基础3.1 手工焊接工艺3.1.1 焊料与焊剂3.1.2 焊接工具的选用3.1.3 保证焊接质量的因素3.1.4 手工焊接的工艺流程和万医3.1.5 导线和接线端子的焊接3.1.6 印制电路板上的焊接3.2 自动焊接技术简介3.2.1 波峰焊接技术3.2.2 二次焊接工艺简介3.2.3 长脚插件一次焊接新工艺简介3.2.4 表面安装技术简介3.3 焊接质量及焊点清洗3.3.1 焊接质量分析3.3.2 焊点的清洗处理习题三第四章 连接工艺和整机总装工艺4.1 连接工艺4.1.1 压接4.1.2 绕接4.1.3 胶接.....第五章 整机的调试、老化和保护第六章 技术文件与安全文明生产第二篇 基本技能训练附录 电子工业工艺文件格式示例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>